

2020年8月27日

各 位

兼松 PWS 株式会社

**兼松 PWS 株式会社、香港の ASM Pacific Technology 社と  
日本市場におけるフォトニクス・プロダクト向け半導体実装装置の販売代理店契約を締結**

兼松 PWS 株式会社（以下、「兼松 PWS」）は、香港を拠点とする ASM Pacific Technology Ltd.（以下、「ASMPT 社」）との間で、日本市場における、高速通信オプトデバイス・車載 MEMS※センサー・パワーデバイス・次世代ディスプレイ向けを中心としたフォトニクス・プロダクト向け半導体実装装置の販売代理店契約を締結いたしました。

本契約により、ASMPT 社製品群のうち、フォトニクス・プロダクト向け半導体実装装置の取り扱いが可能となり、日本の最先端デバイス市場向けに展開をして参ります。取扱装置詳細は①をご参照下さい。

ASMPT 社は、シリコンフォトニクスなど次世代高速通信モジュール、自動運転用高精度レーザーや車載 MEMS センサー、次世代ディスプレイ且つ同光源メーカーの製造工程向けに、半導体実装装置で様々なソリューションを提供しております。特に、微細かつ高精度が求められる上記市場に対して技術的優位性と多くの経験があり、既に米国・欧州・アジア太平洋地域において大手メーカーを中心に多数の納入実績があります。また、ASMPT 社では基盤のダイシングから、ダイボンディング、ワイヤボンディング、そしてパッケージの外観検査まで、一貫したフォトニクス・プロダクト向け半導体実装装置を取り揃えており、お客様のニーズやご要望に合わせてワンストップ体制でお応え出来るサービスの提供を可能にしております。

兼松 PWS は日本法人にあたる「エー・エス・エム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社」とも協力し、日本の最先端デバイス市場において、より良い半導体実装製造ソリューションを提供して参ります。

① 取扱装置：

マルチレーザーダイシング、高精度ダイボンダー、ワイヤーボンダー、マイクロレンズ組立装置、パッケージ外観検査装置。

※MEMS: Micro Electro Mechanical Systems の略称で、機械要素部品、センサー、アクチュエータ、電子回路を一つのシリコン基板、ガラス基板、有機材料などの上に微細加工技術によって集積化したデバイスを指します。

<ASMPT 社の概要>

会社名 : ASM Pacific Technology Ltd.  
設立 : 1975 年  
CEO : Mr. Lee Wai Kwong  
所在地 : 19F, Gateway ts, 8 Cheung Fai Road, Tsing Yi, New Territories,  
Hong Kong  
事業概要 : 半導体実装装置の世界的総合メーカー  
URL : <https://www.asmpacific.com/en/>

<本件に関するお問い合わせ先>

兼松 PWS 株式会社 営業部 営業第一課  
担当 松岡・中野  
TEL: [045-544-1811](tel:045-544-1811) E-mail: [pws-eigyo@pwsj.co.jp](mailto:pws-eigyo@pwsj.co.jp)